


1. 请贵司针对我司转换的图纸内容予以确认, 若有误, 请通知我司予以更正。若正确无误, 我司将以此图纸内容进行加工!
2. 请提供此产品的铝垫厚度, 并请核实此产品焊点下面是否有器件或图形等相关信息, 以便我司在产品加工时进行工艺控制。

版本 Rev.	变更历程 Change History	日期 Date
Rev. A	新建立	2012-12-13

备注:
客户确认
Customer Approve

 华天科技(西安)有限公司 HUATIAN TECHNOLOGY(XI' AN) CO., LTD		压焊图编号 Bond Diagram No.	YQFN040001		
制图 Create	PE确认 PE Approve	审核 Review	生效日期 Effective Date	文控中心 Document Control Center	
覃小坤					
客户代码 Customer No.	深圳比特泉	铝垫厚度 (um) Pad Thickness	焊点下面是否有电路 Circuit under Pad		
产品型号 Device Name		焊点最小间距 (um) Min Pad Pitch	焊线条数 (line) Wire Qty	103	
芯片尺寸 (mm ²) Die Size	3.530X3.611	焊窗尺寸 (um ²) Pad Size	芯片最大加工厚度 (mm) Max. Die Thickness	0.280	
最长线长 (mm) Longest Wire Length	PIN21:1.593	封装形式 PKG Type	QFN40L (0606X0.75-0.50)		
最短线长 (mm) Shortest Wire Length	地线: 0.503	LF载体尺寸 (mm ²) Die Pad Size	4.4958X4.4958 -4B	参考图号 Referee No.	
焊丝直径 (um) Wire Diameter	金线 Golden Wire	铜线 Copper Wire	粘胶类型 Glue Type	导电胶 8200T	NA
	20	NA			页码 Page